**合肥市发展和改革委员会**



# 合肥市发展改革委关于发布2024年安徽省

# 产业创新中心“揭榜挂帅”任务榜单的通知

各区（县）发展改革委、有关单位：

为发挥创新平台服务产业发展、引领行业创新的支撑作用，进一步增强区域创新能力，加快打造新质生产力，按照省发展改革委《关于发布2024年安徽省产业创新中心“揭榜挂帅”任务榜单的通知》要求，现将有关事项通知如下。

一、揭榜领域

围绕我市产业发展亟需、产业链供应链“断链、堵链”、技术突破价值大、商业化潜力突出的领域，重点聚焦智能驾驶、车规级芯片、固态电池、电驱动系统、轻量化材料、智能充换电，通用人工智能，低空经济，氢能，生物制造，北斗应用，下一代机器人，量子科技等方向。

二、揭榜条件

省产业创新中心须由具备较强研发能力并已在省内注册的企业或科研院所牵头，联合产业链上下游企业(非牵头单位关联企 业)、高等学校、科研院所、创新平台组成创新联合体申报。鼓励吸引风险投资、产业基金等金融资本参与。具体条件如下：

1.揭榜单位拥有良好的科研条件和稳定的人员队伍，在相关领域具有较强的研发能力和成果转移转化能力，行业影响力和竞争力突出；

2.参与单位近三年内无不良信用记录和重大违法行为；

3.创新中心应围绕行业发展特点和趋势，科学制定远期、中 期和近期发展目标，做到定量与定性相结合，并在提供公共服务和产业化方面提出具有竞争力的量化目标；

4.创新中心应承担技术研发、成果转化、投资孵化、资源共享、人才引育等体系化任务，建立灵活高效的运行机制、人才和成果转化激励机制及知识产权运营管理制度等。

**三、揭榜流程**

1. 揭榜单位编制组建方案并通过所在区（县）发展改革委统一报送，所在区（县）发展改革委负责对揭榜单位申报材料的真实性、完整性及申报单位信用记录等进行审核把关，研究提出推荐意见。(注：在申报时暂不提交纸质材料，待组建方案初审通过后，再另行通知提交纸质组建方案。未通过方案无需报送纸质件。)

2. 省发改委采用专家论证、现场评审等多种方式，择优确定揭榜单位及组建方案。

3. 省发改委向社会公示揭榜情况，对公示无异议的，与揭榜单位签订省产业创新中心建设任务书。

**四、支持方式**

省产业创新中心按照“揭榜挂帅”方式，采取“分批申报、成熟一个、组建一个”的原则布局，完成组建任务后，由省发展改革委组织验收。对验收合格的省产业创新中心，正式核定为“安徽省\*\*\*产业创新中心”并授牌。对省产业创新中心建设单位符合条件的项目，优先推荐为省产业基础能力提升攻关项目、省产业基础共性技术服务平台项目及省重大产业创新计划等。

**五、其他要求**

1. 揭榜单位应对揭榜材料真实性负责。

2.各区（县）发展改革委初审后，于2024年1月28日前报送第一批揭榜名单至市发展改革委(场景创新处)。第二、三、四批分别于4月28日、7月28日、10月28日前报送。

联系电话：0551—63538621。

附件： 1.安徽省产业创新中心组建方案编制提纲

2.2024年安徽省产业创新中心“揭榜挂帅”任务 榜单

2024年1月2日

**附件1**

**安徽省产业创新中心组建方案编制提纲**

**一** **、摘要** **(2500** 字以内)

**二** **、组建依据、背景与意义**

1.本产业领域在经济建设中的地位与作用

2.省内外产业发展状况、趋势与市场分析

3.本产业进一步发展需要解决的主要问题

4.建设产业创新中心的意义与作用

**三、组建单位概况和建设条件**

1.牵头单位概况

2.其他组建单位概况

3.产业创新中心拟产业化的重要科技成果

4.与产业创新中心建设相关的现有基础条件

**四、主要方向、任务与目标**

1.产业创新中心的主要发展方向

2.产业创新中心的主要任务

3.产业创新中心的发展战略与经营思路

4.产业创新中心的近期和中期目标

**五、组织机构、管理与运行机制**

1.产业创新中心的机构设置与职责

2.主要技术带头人、管理人员概况及技术队伍情况

3.运行机制和激励机制

**六** **、建设方案**

1.建设地点

2.建设内容

3.建设周期与进度安排

4.资金来源和预算方案

5.经济社会效益与风险分析

**七、其它需要说明的问题**

**八、** **附件及证明材料**

**附件2**

**2024年安徽省产业创新中心“揭榜挂帅”任务榜单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序** **号** | **组建**  **领域** | **研究方向、难点、目标** |
| 1 | 智能  驾驶 | **研究方向：**L3及以上智能网联汽车  **解决难点：**海量数据的采集、测试的工程化实施，融合系统的容错性和鲁棒性问题，感知系统 的实时性问题，融合系统的环境自适应性问题。  **技术和产业化目标：**围绕重感知轻地图技术路线，研究基于BEV感知技术的复杂动态交通场  景时空理解大模型与实时建图系统，研究自适应决策及控制技术；实现交通参与者行为预测， 实现云标注及AI算法训练；构建车路云图数据闭环数据中心，满足高阶导航自动驾驶功能需 求。实现不少于5个应用场景落地，累计测试与运营里程>2万公里；实现万辆级整车量产。 |
| 2 | 车规级 芯片 | **研究方向：**车规级芯片晶圆制造工艺  **解决难点：**显示驱动芯片、图像传感器芯片、微控制器芯片及逻辑芯片等汽车芯片技术壁垒高、 国产化率低问题。  **技术和产业化目标：**突破55/40纳米显示驱动芯片、55纳米图像传感器芯片、90纳米电源管理 芯片、110/40纳米微控制器芯片及28纳米逻辑芯片的晶圆制造成套工艺技术；各工艺技术平 台满足IATF16949质量管理体系要求，车用芯片产能>3万片1月。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **研究方向：**满足汽车核心电控单元ASIL等级需求的车规级微控制器(MCU)芯片开发  **解决难点：**满足复杂使用环境(温度、湿度、电磁兼容性等)、可靠性、安全性、 一致性、使 用寿命、长期供货能力等要求。  **技术和产业化目标：**MCU芯片符合国内外高等级信息安全需求标准，通过AEC-Q100认证，  通过IATF16949质量管理体系认证及ISO26262功能安全认证；应用于动力底盘域、新能源三 电以及全新电子电气架构下的区域控制器等；出货量不低于1百万颗。 |
| 3 | 固态  电池 | **研究方向：**长寿命高比能固态电池  **解决难点：**固态电池固/固界面精准构建、动力学精确调控问题，突破超薄固态电解质强度低、 厚密正极界面阻抗高和宽温区性能差等实用化瓶颈。  **技术和产业化目标：**20安时以上固态电池能量密度≥500Wh/kg,常温1C循环寿命≥1000次。 |
| 4 | 电驱动  系统 | **研究方向：**新能源汽车集成式电驱动系统  **解决难点：**电驱动系统效率不高问题，小三电和大三电深度集成的多合一技术问题。  **技术和产业化目标：**面向中高端新能源汽车，开发800V高压高效集成式电驱动系统，提高功 率密度和可靠性，重量、体积缩减10%~20%,降低动力系统成本，在新能源整车企业进行试  用，并实现大批量推广。 |
| 5 | 轻量化  材料 | **研究方向：**铝基轻量化材料  **解决难点：**高强高韧挤压铝合金新材料制备体系， 一体化免热处理压铸铝合金材料与工艺。  **技术和产业化目标：**开发绿色节能再生铝冶炼技术、免热处理铝合金压铸技术、铝合金复杂结 构件成形工艺、高强高韧挤压铝合金新材料制备体系，实现核心装备智能化。建设铝合金大型 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 生产制造基地(压铸、挤压);实现铝合金材料制备-成形工艺-性能评估-装备研发等全链条产 品开发技术产业化示范。铝型材：抗拉强度>380MPa,伸长率≥15%;免热处理铝合金：屈服  强度≥140MPa,伸长率≥12%。 |
| **研究方向：**镁基轻量化材料  **解决难点：**镁合金制造与精深加工的一体化短流程技术，大型薄壁镁合金零部件的一体化压铸 技术。  **技术和产业化目标：**开发绿色节能大型镁冶炼技术、镁合金制造与精深加工的一体化短流程技 术、大型薄壁镁合金一体化压铸技术、镁渣综合处理技术，实现核心装备智能化。建设镁合金 大型生产制造基地、镁合金冶炼-合金-加工-处理-资源综合利用全产业链制造基地，年产能>10 万吨/年，实现生产能耗显著降低。 |
| 6 | 智能充  换电 | **研究方向：**多车型多尺寸动力电池智能充换电  **解决难点：**多尺寸动力电池包柔性换电问题，充换电站智能运维问题。  **技术和产业化目标：**开发车桩(站)互联互通实时数据交互平台，设计充换电设施网点布局，  规划站点构型；开发用户行为识别与充电设施状态感知协同的车群充电规划方法与引导技术； 实现快换电池包标准化，开发多车型共用快换设备以及800V以上高压充电桩电器模块、液冷 装置等。 |
| 7 | 通用人 工智能 | **研究方向：**通用人工智能人机交互  **解决难点：**突破情感可控语音合成系统、合成文本情感预测技术、情感迁移技术以及焦点可控 语音合成技术。  **技术和产业化目标：**开发通用人工智能人机交互的多模态感知、对话理解交互、情感语音合成 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 等技术，实现基于视听的多模态技术相比单模态语音技术，复杂场景语音识别率相对提升30%;  在主动对话方面，基于场景事理图谱的主动交互对话成功率不低于80%;在情感可控语音合成 系统方面，合成情感语音MOS达到4.2以上。 |
| 8 | 低空  经济 | **研究方向：**无人机及遥感数据采集处理、低空智联  **解决难点：**通用无人机关键零部件国产化问题，无人机遥感数据的一站式采集和处理的时效性 问题。低空空域管理、低空监视的通信覆盖不足、技术手段单一、管控平台小而杂等问题，低  功耗、低成本与小型化系统难题。  **技术和产业化目标：**研制通用无人机，全面提升整机性能；开发无人机遥感数据的一站式采集 和处理系统；遥感解译地物提取的总体精度均>80%,目标识别精度≥85%。构建通航时空大数  据中心，拓宽低空经济应用，实现>3个示范应用场景或产业化落地；制定低空领域地方标准和 行业标准，建立统一技术标准和体系规范。构建北斗低空监视精准时空网，建设低空飞行数字 孪生平台，实现若干反无人机主动防御系统应用落地；制定低空智联系统解决方案。 |
| 9 | 氢能 | **研究方向：**绿电直接制氢  **解决难点：**碱性电解槽启停响应慢，与可再生电能匹配度差问题；商业用雷尼镍在电解槽关停 时因反向电流导致催化剂氧化而性能衰减的问题。  **技术和产业化目标：**提升碱性电解槽启停响应速率的，实现与可再生电能的直接耦合匹配；优 化电解槽结构，创制新型电极催化剂；碱性电解槽1000次启停小室电压3000A/m²电流密度下 小室电压升高50mV以内。发展新的设计工艺和催化剂涂层技术，制备能应对复杂、严苛情况 的长服役性电极；稳定运行3000A/m²电流密度阴极析氢过电位低于180mV。 |
| 10 | 生物 | **研究方向：**生物基材料单体产业化及其下游产品开发 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 制造 | **解决难点：**秸秆成分复杂、秸秆高值化利用问题。  **技术和产业化目标：**开发乳酸一步法制备丙交酯技术，突破聚乳酸全产业链关键技术，聚乳酸 熔点指标≥178℃,光学纯度≥99.5%;实现以乳酸为核心单体的下游生物基高分子材料等技术开  发及应用。实现2,5-呋喃二甲酸(FDCA)的产业化放大，以及以FDCA为核心单体的下游生 物基高分子材料的技术开发及应用。 |
| 11 | 北斗  应用 | **研究方向：**北斗精准时空底座与北斗应用新模式  **解决难点：**时空智能关键元器件和基础应用软件的卡脖子问题，复杂环境下北斗时空服务精准 性、连续性与可靠性。  **技术和产业化目标：**开发融合抗干扰、高动态、高精度的单北斗系统级芯片(Soc),支持伪距  差分和载波相位差分定位，首次定位时间优于30s,单点定位精度优于5米，差分定位精度优  于0.3m+10ppm\*D(1o);构建融合区域无线定位网与融合通信网的北斗精准时空基础网，建设  北斗时空大数据中心，构建室内外、二三维一体的“北斗高精度数字孪生底图”,打造“端云”一 体化北斗时空智能体系。卫星导航信号拒止环境下的定位精度优于1米；具备对北斗时空数据 恢复与预测能力，在50%数据缺失情况下，能够恢复出75%的数据；对未来5min内时空数据  平均预测误差不高于10%。 |
| 12 | 下一代 机器人 | **研究方向：**机器人制造与集成  **解决难点：**刚柔混合驱动器设计与制造，突破高力矩密度、精度、效率的变刚度驱动器设计制 造难题，基础通用标准和关键核心标准制修订，解决产品保障问题。  **技术和产业化目标：**面向工业制造、特种应用等领域，重构机器人控制架构，突破虚拟控制器 高精度仿真，开发具有自主学习、自主决策和协同作业能力的智能机器人。机器人智能化水平 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ≥L3级，在汽车、3C、航天、油气化工、灾害救援、物流搬运等领域实现≥5000台智能机器人 示范应用。加强机器人整机制造与系统集成的协同发展，完善智能机器人硬件接口标准、软件 接口协议标准以及安全使用标准。 |
| **研究方向：**人形机器人  **解决难点：**人形机器人多模态感官感知融合、驱动控制技术难题，机器人场景应用验证问题。  **技术和产业化目标：**研制仿人机械臂、灵巧手和腿足，突破全身多关节运动控制、高扭矩密度 一体化关节等技术，实现轻量化与刚柔耦合设计、全身协调运动控制、手臂动态抓取灵巧作业， 具备环境感知、行为控制、人机交互能力。机器人全身具备≥30个高性能伺服关节，具备自主 导航规划功能，整机产品达到国内先进水平；在工业制造、灾害救援、危险作业、民生服务、 军民融合等领域，完成≥3个典型应用场景的验证，并实现批量生产。 |
| 13 | 量子  科技 | **研究方向：**量子通讯、量子计算等  **解决难点：**特殊半导体材料、低温制冷设备、低温测控芯片、高速驱动电路芯片等存在“卡脖 子”困境。  **技术和产业化目标：**开发量子密钥分发(QKD)终端芯片集成技术、远距离光纤QKD技术和  远距离自由空间QKD技术；实现卡片式QKD终端产品，在终端体积不大于1000cm³的情况下  典型成码率≥200kbps@10dB,产品集成度和性能指标达到国际领先水平。攻关大规模量子计算 芯片扩展与互连技术，建设量子芯片中试线，推动量子计算关键设备国产化；搭建量子超融合 算力设施平台，探索新型计算模式。 |